酸化物界面ダイポールを用いた新規メモリの提案

Proposal of new memory device based on oxide interface dipole

産総研 宮田 典幸

AIST Noriyuki Miyata

E-mail: nori.miyata@aist.go.jp

新規不揮発メモリのストレージクラスメモリへの展開やニューロモルフィック応用などへの期待が高まっており、メモリの研究開発は以前にも増して活発である。既に量産化されている PCM や ReRAM の高性能化も進むものと予想されるが、一方で HfO_2 強誘電体のような Si LSI との親和性を持つメモリ技術にもコスト面での利点がある。本報告では、 HfO_2 系酸化物界面に発生するダイポールを利用した新たなメモリ動作について紹介する。

本提案のメモリ動作は、Hf0。/Si 構造で観察された界面ダイポール [1]の研究過程で着想したも のである。Hf0₉/Si 界面のダイポールは、界面近傍の化学結合が持つ電荷の偏りとして説明されて おり [2, FIG. 1 (a)]、この電荷を僅かでも変位できれば、大きな界面ダイポールの変化を生むこ とができると考えた (IDM: Interface Dipole Modulation)。IDM 動作は強誘電体に似た効果を生 むと予想されるが、通常のHfO₂/Si MOS構造からは、期待された IDM動作は確認されていない [FIG. 1 (b)]。一方、Hf0₂/Si 界面に1分子層程度の Ti0₂を挿入することで、強誘電体と同じ反時計回 りの C-V 曲線が得られ、IDM 動作が起こっていると考えた。しかし、この MOS 界面には大きな界 面準位密度 (>1×10¹³ cm⁻² eV⁻¹) が形成されており、Si-FET を用いたフラッシュ型メモリとして 動作させるには適さない。そこで、HfO₂/SiO₂界面に発生するダイポールに注目し、同様の TiO₂ 変調機構を導入したところ [FIG.1 (c)]、僅かなヒステリシス幅ではあるが反時計回りの C-V 曲 線が観察された [FIG. 1 (d)]。Hf0。/Si0。界面のダイポールが 0.3V 以下と小さいことより [1,3]、 変調幅が小さいことは想定された結果である。一方、HfO2およびSiO2膜はアモルファス構造であ るため、容易に積層化が可能であり、各界面に変調機構を挿入することで、IDM 効果を増幅でき ると期待される [FIG. 1 (e)]。実際、6層の IDM 構造を組込んだ MOS キャパシタは、1層 IDM に比 べて大きなヒステリシスが観察される [FIG. 1 (f)]。また、この多層 HfO₂/SiO₂ IDM 構造では、下 地 SiO₂層にシリコン熱酸化膜を使えるため、界面準位密度を $1 \times 10^{11}~{
m cm}^{-2}~{
m eV}^{-1}$ 以下に抑制できる ことが確認できており、フラッシュ型メモリとして有望であると結論される。

謝辞: 本研究は JSPS 科研費 16H02335 の助成を受けたものです。

[1] Y. Abe *et al.*, *Appl. Phys. Lett.* **90**, 172906 (2007), [2] N. Miyata *et al.*, *J. Appl. Phys.* **110**, 074115 (2011), [3] K. Kita and A. Toriumi, *Appl. Phys. Lett.* **94**, 132902 (2009).

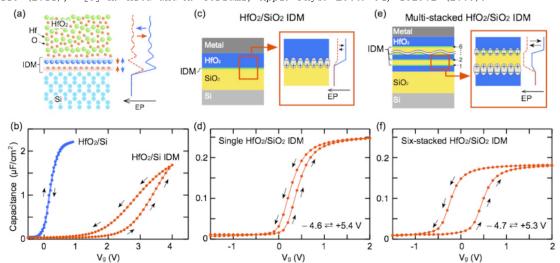


FIG. 1 Concept of interface dipole modulation (IDM) and hysteresis *C-V* curves. (a) IDM operation mechanism at HfO₂/Si interface, (b) *C-V* curves of HfO₂/Si and HfO₂/1-ML TiO₂/Si MOS capacitors, (c) HfO₂/SiO₂ IDM structure, (d) *C-V* curve of single IDM MOS capacitor, (e) multi-stacked HfO₂/SiO₂ IDM structure, and (f) *C-V* curve of six-stacked IDM MOS capacitor.